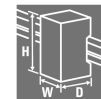


### 제품 이미지



모듈방식 CH20M 하우징의 기본 요소는 여러 가지 장점을 제공하여 프로젝트에 탁월한 선택입니다. 버스 및 FE 연락처를 위한 특수 컷아웃이 있어 특히 유연하고 적응력이 뛰어납니다.

또 다른 장점은 하우징에 레이저 인쇄 옵션이 있어 높은 정밀도와 개별 디자인 옵션을 제공한다는 것입니다. 다양한 색상도 사용 가능하여 원하는 대로 하우징을 디자인할 수 있습니다.

CH20M 하우징은 표준 조립 레일에 적합하기 때문에 기존 시스템에 설치하고 통합하는 것이 더 쉽습니다.

### 일반 주문 데이터

버전	모듈형 하우징, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 아게이트 그레이, 베이스 요소, 너비: 17.5 mm
주문 번호	<a href="#">2554640000</a>
유형	CH20M17 B AGY/BK 3747
GTIN (EAN)	4050118565041
수량	12 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	108 mm	깊이 (인치)	4.252 inch
높이	109.3 mm	높이 (인치)	4.3031 inch
너비	17.5 mm	폭 (인치)	0.689 inch
순중량	29.86 g		

온도

주변 온도	-25 °C...85 °C	작동 온도 범위	-40...120 °C
습도	5 - 93 % 상대 습도, Tu = 40°C, 비응축		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	PA 66 GF 30
절연재 그룹	I	표면 마감	미처리
기본 재질	플라스틱	CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	600 ≤ CTI

일반 데이터

컬러 코드	아게이트 그레이	보호 등급	IP20(설치 상태)
장착 레일	TS 35	컬러 차트(유사)	RAL 7038
캡슐화 옵션	아니요		

조립품 속성

장착 어셈블리 암형 커넥터용 슬롯 수, 최대	6	PCB 개수, 최대	1
결선 수준 수, 최대	3	극 수, 최대	18
PCB의 콤포넌트 높이, 최대	11.1 mm	PCB 어셈블리 유형	양면

열 테스트

열 시험	시험 조건	하우징 3개 연속 설치 - 간격 없음
	시험 액슬	수평
	주변 온도	80 °C
	전력 방출, 최대	0.9 W
	주변 온도	60 °C
	전력 방출, 최대	1.7 W
	주변 온도	40 °C
	전력 방출, 최대	2.45 W
	주변 온도	20 °C
	전력 방출, 최대	3.2 W

기술 데이터

부품 속성

클립온곳 색상	검정	결선 수준 수, 최대	3
---------	----	-------------	---

디자인 - IN 요구 사항

PCB 형태에 대한 공차	±0.1 mm	PCB 두께	1.6 mm
회로 보드 두께의 공차	±0.15 mm		

개별화 옵션

고객 맞춤 라벨 표시 가능	예	고객 특정적 주문 절차	다운로드 아래 지침 참조
대체 색상	요청 시 추가	처리 가능성	레이저 가공

중요 참고 사항

제품 정보	회로기판 윤곽, 제한 구역 및 그 외 회로기판 설계 관련 정보는 다운로드 섹션의 해당 수형 헤더 아래의 결선 기술 카테고리에서 확인하실 수 있습니다.		
-------	---	--	--

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

도면

제품 이미지



제품 이미지



발 부분 스냅인에 컷아웃 없는 베이스 요소

치수 도면

